



H6060 单组分导热凝胶

产品描述

条目	描述
技术类型	有机硅, 单组分
外观	灰色膏状
典型应用	新能源汽车电芯、模组中的散热; 电子元器件散热片、倒装芯片、变压器、大功率 LED 等有散热要求的应用

- 低的界面热阻
- 良好的粘接性
- 良好的可操作性
- 低的挥发量
- 良好的可靠性

产品性能

条目	典型值	备注
粘度(Pa.s@5s ⁻¹)	1600±200	ASTM D2196
比重 g/cm ³	3.45	GB/T13354
挤出率 g/min	30	3mm @ 90 PSI
导热系数 (w/m.k)	6.0	ASTM D5470
热阻(K·cm ² /W)	0.1	ASTM D5470
最小厚度 mm	0.2	ASTM D5470
体积电阻率 Ω.cm	1.0×10 ¹²	GB/T 1692
介电强度 KV/mm	6	GB/T1695
挥发份 (%)	<0.4	150°C/24h

使用指南

使用自动点胶机点胶时, 设置好出胶量及点胶路径施胶到发热源元件面上, 然后与散热元件压合好即可, 若需要返修或多余的胶料可以用无尘布轻易擦掉。

导热凝胶在贮存过程中, 管口处有可能出现少量的 固化或析油现象, 将之清除后可正常使用, 不影响产品性能。



标准包装

- 30ml/支, 310ml /支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

储存温度：8-28℃**保存，有效存储期为 3 个月。**

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com